(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 28. März 2002 (28.03.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/24985 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation7: C30B 25/14. C23C 16/455
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/08139
- (22) Internationales Anmeldedatum:

14. Juli 2001 (14.07.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 61 671.2 100 64 941.6

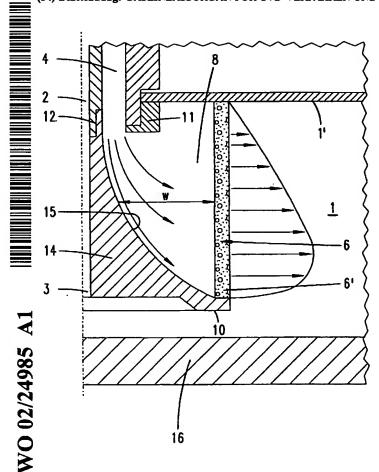
22. September 2000 (22.09.2000) DE 23. Dezember 2000 (23.12.2000) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): AIXTRON AG [DE/DE]; Kackertstrasse 15-17, 52072 Aachen (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (mar für US): STRAUCH, Gerd [DE/DE]; Schönauer Friede 80, 52072 Aachen (DE). KÄPPELER, Johannes [DE/DE]; Zeisigweg 47, 52146 Würselen (DE). DAUELSBERG, Martin [DE/DE]; Kuckhoffstrasse 4, 52064 Aachen (DE).
- (74) Anwälte: GRUNDMANN, Dirk usw.; Corneliusstrasse 45, 42329 Wuppertal (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: GAS INLET MECHANISM FOR CVD-METHOD AND DEVICE

(54) Bezeichnung: GASEINLASSORGAN FÜR CVD-VERFAHREN UND VORRICHTUNG



(57) Abstract: The invention relates to a method for depositing especially, crystalline layers onto especially, crystalline substrates. At least two process gases are led into a process chamber (1) of a reactor separately from each other, through a gas inlet mechanism above a heated susceptor (16). The first process gas flows through a central line (2) with a central outlet opening (3) and the second process gas flows through a line which is peripheral thereto and which has a peripheral outlet opening that is formed by a gas-permeable gas outlet ring (6). Said gas outlet ring (6) surrounds a ring-shaped pre-chamber (8). The invention provides that in order to avoid a parasitic deposition in the area of the peripheral outlet opening, the end section (6') of the gas outlet ring (6) that faces towards the susceptor or the radially outer section of the surface of the gas outlet mechanism surrounding the central outlet opening (3) is cooled by the second process gas according to a truncated cone or revolution hyperboloid shape of a gas guiding surface formed by the pre-chamber back wall (15).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abscheiden von insbesondere kristallinen Schichten auf insbesondere kristallinen Substraten, wobei zumindest zwei Prozessgase getrennt voneinander durch ein Gaseinlassorgan oberhalb eines beheizten Suszeptors (16) in eine Prozesskammer (1) eines Reaktors eingeleitet werden, wobei das erste Prozessgas durch eine zentrale Leitung (2) mit einer zentralen Austrittsöffnung (3) und das zweite

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

GASBINLASSORGAN FÜR CVD-VERFAHREN UND VORRICHTUNG 00001 00002 00003 Die Erfindung betrifft zumächst ein Verfahren zum Ab-00004 scheiden von insbesondere kristallinen Schichten auf 00005 insbesondere kristallinen Substraten, wobei zumindest 00006 zwei Prozessgase getrennt voneinander durch ein Gasein-00007 lassorgan oberhalb eines beheizten Suszeptors in eine 80000 00009 Prozesskammer eines Reaktors eingeleitet werden, wobei das erste Prozessgas durch eine zentrale Leitung mit 00010 00011 einer zentralen Austrittsöffnung und das zweite Prozessgas durch eine dazu periphere Leitung mit von einem 00012 qasdurchlässigen Gasauslassring gebildeten peripherer 00013 00014 Austrittsöffnung strömt, welcher Gasauslassring eine ringförmige Vorkammer umgibt. Die Erfindung betrifft 00015 ferner ein Gaseinlassorgan für eine Vorrichtung zum 00016 Abscheiden von insbesondere kristallinen Schichten auf 00017 00018 insbesondere kristallinen Substraten, mittels welchem 00019 zwei Prozessgase getrennt voneinander oberhalb eines 00020 beheizten Suszeptors in eine Prozesskammer eines Reak-00021 tors einleitbar sind, mit einer zentralen Leitung mit 00022 zentraler, stirnseitiger Austrittsöffnung für das erste 00023 Prozessgas und mit einer dazu peripheren Leitung mit 00024 peripherer Austrittsöffnung für das zweite Prozessgas, 00025 welche von einem gasdurchlässigen Gasauslassring gebil-00026 det ist, welcher eine ringförmige Vorkammer umgibt, 00027 deren radiale Weite zufolge einer im Längsschnitt 00028 umparallel zur zentralen Achse verlaufenden Rückwand zum freien Ende des rotationssymmetrischen Gasauslass-00029 00030 organs abnimmt. 00031 00032 Ein derartiges Gasauslassorgan ist bekannt und wird 00033 verwendet, um die Reaktionsgase insbesondere für einen 00034 MOCVD-Prozess in eine zylindersymmetrische Prozesskam-00035 mer einzubringen, durch welche die Prozessgase in radia2

ler Richtung strömen, um durch einen die Prozesskammer 00036 umgebenden Ring wieder auszutreten. Um das Gaseinlass-00037 organ sind auf dem von unten insbesondere mittels Hoch-00038 frequenz beheizten Suszeptor planetenartig Substrate 00039 angeordnet, welche mit den Zerfallsprodukten der durch 00040 00041 das Gaseinlassorgan eingebrachten Reaktionsgase be-00042 schichtet werden. Die Prozesskammer besitzt im Bereich 00043 des Gaseinlassorganes bzw. den unmittelbar in Radialaus-00044 wärtsrichtung daran angrenzenden Bereich eine Einlass-00045 zone, in welcher die gasförmigen Ausgangsstoffe zerfal-00046 len. In Radialauswärtsrichtung schließt sich an diese 00047 Einlasszone eine Depositionszone an, innerhalb welcher 00048 die Zerfallsprodukte hin zum Substrat diffundieren, um 00049 dort zu einer einkristallinen Schicht zu kondensieren. 00050 00051 Bei der bekannten Vorrichtung tritt das zweite Pro-00052 zessgas durch die periphere Zuleitung axial in das Zentrum der Prozesskammer. Als zweites Prozessgas wird 00053 00054 beispielsweise TMG oder TMI zusammen mit einem Trägergas beispielsweise Wasserstoff verwendet. Das Gas tritt 00055 gegen eine von der im Wesentlichen glockenförmig verlau-00056 fenden Rückwand der Vorkammer gebildeten Prallwand. Der 00057 Gasauslassring besitzt kammartige Schlitze, durch wel-00058 che das Gas von der Vorkammer in die Rinlasszone der 00059 00060 Prozesskammer strömen kann, um dort vorzerlegt zu werden. Durch die zentrale Zuleitung treten zusammen mit 00061 einem Trägergas die Metall-Hydride, bspw. Phosphin oder 00062 00063 Arsen in die Prozesskammer ein. Die zentrale Öffnung ist nahe dem beheizten Suszeptors angeordnet. Dieses 00064 dort austretende Prozessgas strömt durch einen Spalt 00065 zwischen der Oberfläche des beheizten Suszeptors und 00066 der Stirnfläche des freien Endes des Gaseinlassorganes. 00067 00068 Zufolge der Temperaturstrahlung des beheizten Suszeptors kann sich die Stirnfläche des Gaseinlassorganes 00069 00070 aufheizen. Rinhergehend damit heizt sich der gesamte

3

00071 Quarz-Körper, der den in die Prozesskammer ragenden 00072 Abschnitt des Gaseinlassorganes ausbildet, auf. Dabei 00073 kann insbesondere der dem freien Ende des Gaseinlass-00074 organes zugeordnete Abschnitt der Vorkammer bzw. der 00075 daran angrenzende Abschnitt des Gasauslassrings Tempera-00076 turen erreichen, bei welchen die durch die periphere 00077 Leitung zugeführten metallorganischen Verbindungen von 00078 Gallium oder Indium zerlegt werden, so dass in diesem 00079 Bereich der Vorkammer bzw. am Gasauslassring eine Deposition von Galliumarsenid oder Indiumphosphid auf-00081 tritt. Diese parasitären Despositionen sind nachteil-00082 haft. 00083 00084 Während Galliumarsenid bzw. Indiumphosphid auf heißen Oberflächen deponiert, kann es bei einem zu kalten 00085 00086 äußeren Umfangsabschnitt der die zentrale Zuleitung umgebenden Stirnfläche dort zu Phosphor- oder Arsenkon-00087 00088 densationen kommen. Auch dies ist nachteilhaft. 00089 00090 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Maßnahmen 00091 vorzuschlagen, um einerseits einer parasitäre De-00092 position im Bereich der peripheren Austrittsöffnung und andererseits einer Kondensation der durch die zentrale 00093 00094 Austrittsöffnung austretenden V-Komponente am radial äußeren Umfangsabschmitt der Stirnfläche des Gasaus-00095 00096 lassorganes entgegen zu wirken. 00097 00098 Gelöst wird die Aufgabe durch die in den Ansprüchen angegebene Erfindung. Der Anspruch 1 schlägt vor, dass 00099 00100 zufolge einer Kegelstumpf- oder Rotationshyperboloid-00101 Form einer von der Vorkammerrückwand gebildeten Gas-Leitfläche der dem Suszeptor zugewandte Endabschnitt 00102 des Gasauslassringes bzw. der radial äußere Abschnitt 00103 der die zentrale Austrittsöffnung umgebenden Stirnseite 00104 00105 des Gasauslassorgans vom zweiten Prozessgas gekühlt

00106	wird. Dabei wird der aus der zweiten Zuleitung der
0107	Prozesskammer zuzuführende Gasstrom von der Gasleitflä-
00108	che derart umgelenkt, dass er sich an der durch die
00109	Strahlung des Suszeptors aufgeheizten Rückwand des in
00110	die Prozesskammer ragenden Abschnittes des Gaseinlass-
00111	organes erwärmt. Die dabei abgeführte Wärme kühlt den
00112	suszeptornahen Abschnitt der Vorkammer bzw. des Gasaus-
00113	lassringes. Dabei kann die Form der Gasleitfläche so
00114	gewählt werden, dass die Kühlung nur in dem Maße auf-
00115	tritt, dass die Temperatur im Endabschnitt des Gasein-
00116	lassorganes in einem Temperaturfenster gehalten wird,
00117	welches nach unten begrenzt ist durch die Deposition-
00118	stemperatur der V-Komponente und nach oben durch die
00119	Depositionstemperatur der III-V-Verbindung. Der Druck
00120	in der Vorkammer wird zufolge eines porösen Gasaus-
00121	lassringes bevorzugt größer gehalten, als der Pro-
00122	zesskammerdruck. Die Verwendung eines porösen Gasaus-
00123	lassrings hat zudem gegenüber dem kammartigen Gasaus-
00124	lassring den Vorteil, dass sich hinter den Kammzinken
00125	keine Wirbel bilden, die einer parasitären Deposition
00126	förderlich sind. Besteht das Gasauslassorgan bspw. aus
00127	einer Quarz-Fritte, so tritt das Prozessgas homogeni-
00128	siert aus dem Gasauslassring aus, wobei das Strömungs-
00129	maximum des Strömungsprofils außermittig liegt und zwar
00130	versetzt hin zum freien Ende des Gaseinlassorganes. Der
00131	Krümmungsradius der im Längsschmitt konkaven Leitfläche
00132	ist an die Strömungsparameter angepasst. Bei höheren
00133	
00134	als bei kleineren Volumensströmen. Die Längsschnitts-
00135	kontur der Gasleitfläche kann dann insbesondere eine
00136	Gerade sein, so dass die Gasleitfläche insgesamt eine
00137	Kegelstumpfform bekommt. Um die Gasleitflächenkontur
00138	den verschiedenen Prozessparametern wie Temperatur und
00139	Gesamtströmungsvolumen anpassen zu können, ist erfin-
00140	dungsgemäß vorgesehen, dass der in die Prozesskammer

00141	ragende Abschr	itt des Gaseinlassorgans als Auswechsel-
00142	teil ausgebild	et ist. Dieses kann mit der Zuleitung
00143	verschraubt we	erden. Es handelt sich dabei bevorzugt um
00144	ein Quarz-Teil	., welches auch Träger des Gasauslassrin-
00145	ges ist. Der G	asauslassring besitzt eine von der Vorkam-
00146	merrückwand ge	bildete kegelstumpfförmig oder rotations-
00147	hyperboloid-fö	rmig gestaltete Gasleitfläche, die sich
00148	stufenfrei an	die Zuleitung anschließt. Durch den an
00149	der Gasleitflä	iche laminar entlangströmenden Gasstrom
00150	wird eine konv	ektive Kühlung erzielt. Durch den im
00151	suszeptornaher	Bereich erhöhten Austrittsstrom aus dem
00152	Gasauslassring	, wird zudem ein Spüleffekt erzielt. Bei
00153	einem Galliuma	rsenid-Abscheidungsprozess wird die Tempe-
00154	ratur des susz	eptornahen Abschnittes des Gaseinlass-
00155	organs in eine	em Temperaturfenster zwischen etwa 200°C
00156	und etwa 400°C	gehalten.
00157		
00158	_	spiele der Erfindungen werden nachfolgend
00159	anhand beigefü	igter Zeichnungen erläutert. Es zeigen:
00160		
00161	Fig. 1	ein erstes Ausführungsbeispiel eines
00162		Gaseinlassorganes,
00163		
00164	Fig. 2	einen Schnitt gemäß der Linie II-II,
00165		
00166	Fig. 3	einen Schnitt gemäß der Linie III-III,
00167		
00168	Fig. 4	einen Schmitt gemäß der Linie IV-IV,
00169		
00170	Fig. 5	ein zweites Ausführungsbeispiel gemäß
00171		Fig. 1 und
00172		
00173	Figuren 6-9	einen Umrüstsatz mit verschieden
00174		gestalteten Auswechselteilen.
00175		

6

Das Ausführungsbeipiel gemäß den Figuren 1 bis 5 stellt 00176 einen Ausschnitt aus einem MOCVD-Reaktor dar. Die Prozesskammer trägt die Bezugsziffer 1. Sie besitzt einen 00178 Boden 1' und Decke 1''. Der Boden 1' ist die Oberfläche 00179 eines von unten mittels Hochfrequenz beheizten Suszep-00180 tors 16, welcher aus Graphit besteht. Im Zentrum der 00181 zvlindersymmetrischen Prozesskammer 1 befindet sich das 00182 Gaseinlassorgan. Dieses besitzt eine zentrale Zuleitung 00183 2, welche in eine zentrale Austrittsöffnung 3 mündet. 00184 Diese zentrale Austrittsöffnung liegt in einer Stirnsei-00185 tenkammer des Gaseinlassorganes. Die Stirnseite ist 00186 einem Quarz-Körper 14 zugeordnet. Dieser besitzt eine 00187 kegelstumpfförmige Wandung, die eine Gasleitfläche 15 00188 ausbildet für das aus einer peripheren Zuleitung 4 00189 axial ausströmende Gas. Das aus der peripheren Zulei-00190 tung 4 ausströmende Gas strömt in eine zwischen Pro-00191 zesskammerdecke 1'' und Prozesskammerboden 1' angeordne-00192 te ringförmige Vorkammer 8, deren Rückwand von der 00193 Gasleitfläche 15 gebildet ist. 00194 00195 00196 Die ringförmige Vorkammer 8 wird von einem porösen Gasauslassring 6, welcher als Quarz-Fritte gefertigt 00197 ist, umgeben. Durch diesen Gasauslassring kann das 00198 durch die periphere Leitung 4 einströmende zweite Pro-00199 zessgas in einem homogenisierten Strömungsprofil austre-00200 00201 ten. 00202 Der Vorkammer 8 ist eine Ringdrossel 7 mit einer Viel-00203 zahl von Durchtrittsöffnungen 9 vorgeordnet. Der Ring-00204 drossel 7 wiederum ist eine Mischkammer vorgeordnet, in 00205 welche zwei Gaszuleitungen 5, 5' an den mit den Bezugs-00206 ziffern 13 bzw. 13' bezeichneten Stellen minden. 00207 00208

00209 Die in Fig. 5 dargestellte Ringdrossel 7 hat zufolge

00210 ihrer vergrößerten Dicke eine höher Drosselfunktion.

7

Die in den Figuren 6 bis 9 dargestellten Auswechseltei-00211 le 14 können mittels einer Schraubverbindung 12 mit dem 00213 oberen Teil des Gaseinlassorganes, welches die zentrale Zuleitung 2 und die periphere Zuleitung 4 ausbildet, 00214 00215 verschraubt werden. Mit diesem oberen Abschnitt ist auch eine Mutter 11 verschraubt, die eine Platte trägt, 00216 00217 welche die Prozesskammerdecke 1' bildet. Der untere Abschnitt 6' des Gasauslassringes 6 ruht auf einem 00218 dünnwandigen radialen Ringvorsprung, der von dem Randab-00219 schnitt 10 des Auswechselteiles 14 gebildet ist. Oben 00220 stützt sich der Gasauslassring 6 an der besagten Platte 00221 00222 bzw. an der Prozesskammerdecke 1' ab. 00223 00224 Die einzelnen Auswechselteile 14 der Figuren 6 bis 9 unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihren Durchmes-00225 00226 ser und durch die Form ihrer Leitflächen voneinander. 00227 Die Leitflächen 15 der Auswechselteile der Figuren 6, 7 00228 und 9 haben im Wesentlichen die Form eines Rotationshyperboloiden. In der dargestellten Längsschmittebene hat 00229 die Konturlinie der Gasleitfläche 15 eine konkave Form, 00230 00231 die sich sprungstellenfrei an die Wandung der peripheren in Achsrichtung verlaufende Leitung 4 anschließt, 00232 so dass sich entlang der Gasleitfläche 15 keine Wirbel 00233 00234 bilden. Die außerhalb des Gasauslassringes 6 dargestellten Pfeile deuten das axiale Strömungsprofil an. Es ist 00235 zu erkennen, dass das Maximum dieses Profil dem suszep-00236 00237 tornahen Ende 6' des Gasauslassringes näher liegt, als dem der Prozesskammerdecke 1' nahen Bereich des Gasaus-00238 lassringes. Dies hat zur Folge, dass der suszeptornahe 00239 Bereich und damit auch der Randabschnitt 10 stärker 00240 00241 konvektiv gekühlt wird. Die Weite W der Ringkammer 8 nimmt bei allen Ausführungsbeispielen in axialer Rich-00242 tung von der Decke 1' zum Suszeptor 16 ab. 00243 00244

8

00245 Bei dem in der Fig. 8 dargestellten Ausführungsbeispiel 00246 besitzt die Konturlinie der Gasleitfläche 15 des Längs-00247 schnittes die Form einer Geraden, so dass die Leitfläche 15 eine Kegelstumpfform besitzt. Diese Form wird 00248 00249 bei großen Volumenströmen gewählt. 00250 00251 Der Suszeptor 16 ist von unten mittels einer nicht dargestellten Hochfrequenzheizung beheizt. Der Susze-00252 ptor 16 strahlt Wärme ab, die den Quarz-Körper 14 des 00253 Gasauslassorganes aufheizt. Durch die zentrale Aus-00254 trittsöffnung 3 strömt das aus Arsen oder Phosphin und 00255 00256 Wasserstoff bestehende erste Prozessgas. In dem Spalt 00257 zwischen dem Quarz-Körper 14 und der Oberfläche des 00258 Suszeptors 16 zerlegt sich das durch die Öffnung 3 00259 heraustretende Arsen bzw. Phosphin. Die Zerlegungspro-00260 dukte werden in Radialrichtung weitertransportiert. Aus 00261 der peripheren Leitung 4 strömt TMG oder TMI zusammen 00262 mit Wasserstoff als zweites Prozessgas zunächst in die 00263 Vorkammer 8. Das aus der axialen Leitung 4 austretende 00264 Gas strömt laminar entlang der Leitfläche 15 und wird 00265 dabei um 90° umgelenkt. Es überströmt dabei den Randab-00266 schmitt 10. Da das aus der Leitung 4 strömende Gas 00267 nicht vorbeheizt ist, sondern im Wesentlichen Raumtempe-00268 ratur besitzt, hat es gegenüber dem Quarz-Körper 14 00269 eine kühlende Wirkung. Die Wärme wird dabei über die 00270 Leitfläche 15 aufgenommen. Insbesondere dort, wo die 00271 Materialstärke des Quarz-Teiles 14 am geringsten ist, 00272 nämlich im Bereich des Randabschnittes 10 entfaltet der 00273 Gasstrom seine größte Kühlwirkung. Dieser Bereich und insbesondere der dem Randabschnitt 10 benachbarte Gas-00274 auslassringabschnitt 6' werden deshalb vom Gasstrom am 00275 stärksten gekühlt. Die Prozesskammerdecke 1' ist unbe-00276 heizt. Demzufolge wäre der Bereich 6' des Gasauslassrin-00277 ges 6 ohne einen kühlenden Gasstrom am heißesten, da er 00278 dem heißen Suszeptor 16 am nächsten liegt. Zufolge der

00280	konvektiven Kühlung des aus der Leitung 4 tretenden
00281	Prozessgases wird der suszeptornahe Bereich 6' des
00282	Gasauslassringes 6 aber auf einer Temperatur gehalten,
00283	die im Wesentlichen der Temperatur des übrigen Berei-
00284	ches des Gasauslassringes 6 entspricht. Diese Tempera-
00285	tur liegt höher, als die Kondensations-Temperatur des
00286	im Spalt zwischen dem Suszeptor 16 und dem Quarz-Körper
00287	14 gebildeten Arsens oder Phosphors. Die Temperatur ist
00288	aber geringer, als die Depositionstemperatur der III-V-
00289	Verbindung.
00290	•
00291	Die Strömungsparameter sollen so eingestellt werden,
00292	dass der Gasauslassring über seine axiale Länge mög-
00293	lichst eine gleichbleibende Temperatur besitzt.
00294	
00295	Die Ampassung des Verlaufs der Gasleitfläche 15 an die
00296	Prozessparameter erfolgt durch Austausch eines Auswech-
00297	selteiles.
00298	·
00299	Alle offenbarten Merkmale sind (für sich) erfindungswe-
00300	sentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird hiermit
00301	auch der Offenbarungsinhalt der zugehörigen/beigefügter
00302	Prioritätsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) voll-
00303	inhaltlich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale
00304	dieser Unterlagen in Ansprüche vorliegender Ammeldung
00305	mit aufzunehmen.

WO 02/24985

10

PCT/EP01/08139

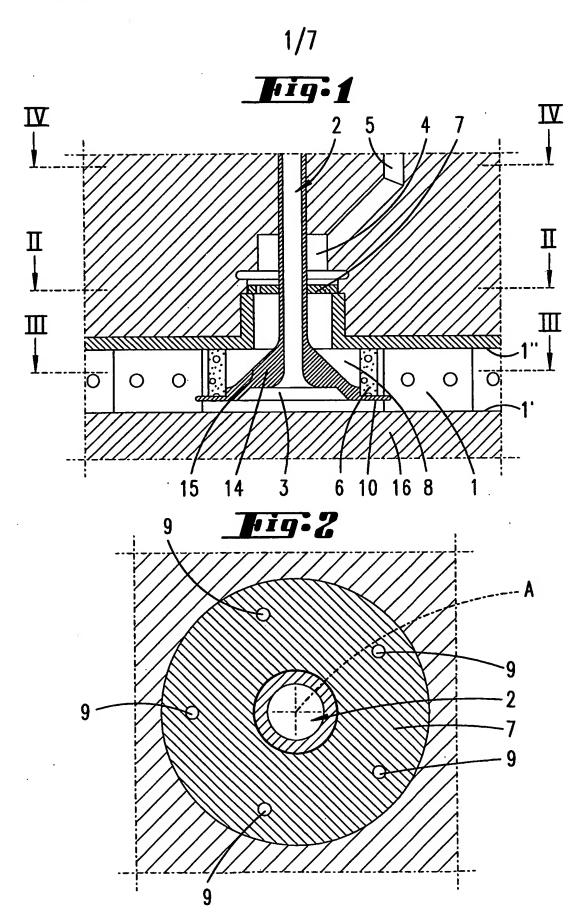
00306	
00307	Ansprüche
00308	
00309	
00310	1. Verfahren zum Abscheiden von insbesondere kristalli-
00311	nen Schichten auf insbesondere kristallinen Substraten,
00312	wobei zumindest zwei Prozessgase getrennt voneinander
00313	durch ein Gaseinlassorgan oberhalb eines beheizten
00314	Suszeptors (16) in eine Prozesskammer (1) eines Reak-
00315	tors eingeleitet werden, wobei das erste Prozessgas
00316	durch eine zentrale Leitung (2) mit einer zentralen
00317	Austrittsöffnung (3) und das zweite Prozessgas durch
00318	eine dazu periphere Leitung (4) mit von einem gasdurch-
00319	lässigen Gasauslassring (6) gebildeten peripheren Aus-
00320	trittsöffmung strömt, welcher Gasauslassring (6) eine
00321	ringförmige Vorkammer (8) umgibt, dadurch gekennzeich-
00322	net, dass zufolge einer Kegelstumpf- oder Rotationshy-
00323	perboloid-Form einer von der Vorkammerrückwand (15)
00324	gebildeten Gasleitfläche der dem Suszeptor zugewandte
00325	Endabschmitt (6') des Gasauslassringes (6) bzw. der
00326	radial äußere Abschmitt der die zentrale Austrittsöff-
00327	nung (3) umgebenden Stirnseite des Gasauslassorgans vom
00328	zweiten Prozessgas gekühlt wird.
00329	
00330	2. Verfahren nach Anspruch 1 oder insbesondere danach,
00331	dadurch gekennzeichnet, dass der Druck in der Vorkammer
00332	(8) zufolge eines porösen Gasauslassringes (6) größer
00333	ist, als in der Prozesskammer (1).
00334	
00335	3. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen-
00336	den Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekenn-
00337	zeichnet, dass der Krümmungsradius der im Längsschnitt
00338	konkaven Leitfläche (15) bei höheren Volumen-Gasströmen
00339	größer gewählt ist.
00340	

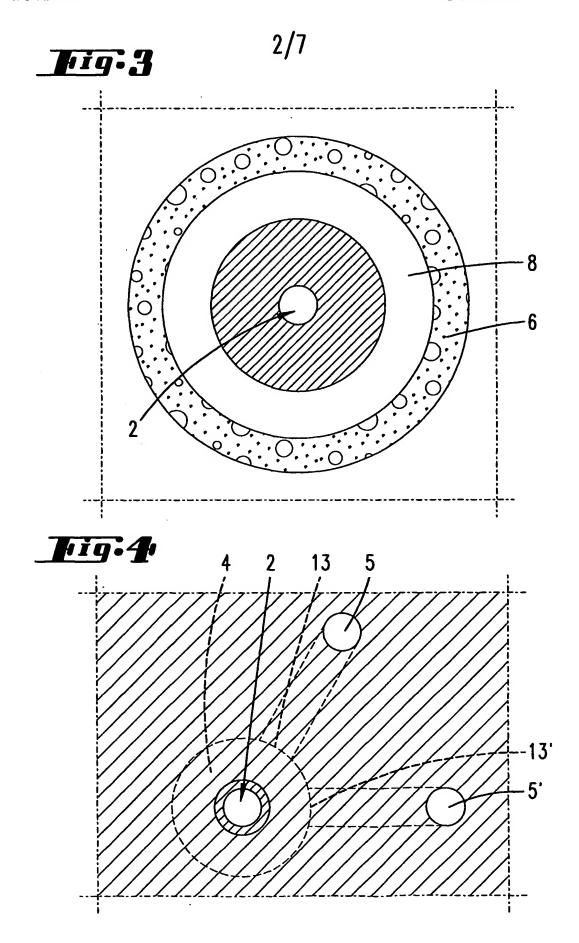
11

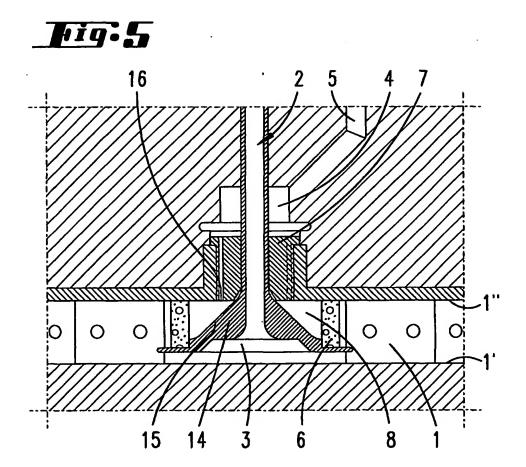
4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekenn-00342 zeichnet, dass das Maximum des aus dem Gasauslassring 00343 (6) tretenden Gasstroms in der Längsschnittebene außer-00344 mittig hin zum freien Ende (6') versetzt liegt. 00345 00346 5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehen-00347 den Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekenn-00348 zeichnet, dass die Strömungsparameter und die Längs-00349 schnittkonturlinie der Gasleitfläche (16) derart aufein-00350 ander abgestimmt sind, dass die Temperatur des dem 00351 heißen Suszeptor (16) benachbarten Abschnitts des Gas-00352 auslassorganes größer ist als die Kondensationstempera-00353 tur des aus Phosphin oder Arsen pyrolytisch zerlegten 00354 Arsens bzw. Phosphors und niedriger ist, als die De-00355 positionstemperatur von Galliumarsenid oder Indiumphos-00356 00357 phid. 00358 6. Gaseinlassorgan für eine Vorrichtung zum Abscheiden 00359 von insbesondere kristallinen Schichten auf insbesonde-00360 re Schichten auf insbesondere kristallinen Substraten, 00361 mittels welchem zwei Prozessgase getrennt voneinander 00362 oberhalb eines beheizbaren Suszeptors (16) in eine 00363 Prozesskammer (1) eines Reaktors einleitbar sind, mit 00364 einer zentralen Leitung (2) mit zentraler stirnseitiger 00365 Austrittsöffmung (3) für das erste Prozessgas und mit 00366 einer dazu peripheren Leitung (4) mit peripherer Aus-00367 trittsöffnung für das zweite Prozessgas, welche von 00368 einem gasdurchlässigen Gasauslassring (6) gebildet ist, 00369 welcher eine ringförmige Vorkammer (8) umgibt, deren 00370 radiale Weite (W) zufolge einer im Längsschnitt umparal-00371 lel zur zentralen Achse verlaufenden Rückwand (15) zum 00372 freien Ende (6') des rotationssymmetrischen Gasauslass-00373 organes abnimmt, gekennzeichnet durch eine von der Vor-00374 kammerrückwand gebildete kegelstumpfförmige oder rotati-

12

onshyperboloid-förmige Gasleitfläche (15) zum konvekti-00376 ven Kühlen des suszeptornahen Abschnittes (61) des Gasauslassringes (6) mittels des an der Gasleitfläche 00378 (15) entlangströmenden Gases. 00379 00380 7. Gaseinlassorgan nach Anspruch 6 oder insbesondere 00381 danach, dadurch gekennzeichnet, dass der Gasauslassring 00382 (6) aus porosem Material besteht und insbesondere eine 00383 Quarz-Fritte ist. 00384 00385 8. Gaseinlassorgan nach Anspruch 6 und 7 oder insbeson-00386 dere danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasleit-00387 fläche (15) einem Auswechselteil (14) zugeordnet ist. 00388 00389 9. Gaseinlassorgan nach Anspruch 6, 7 und 8 oder insbe-00390 sondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass sich die 00391 Gasleitfläche (15) stufenfrei der Zuleitung (4) an-00392 00393 schließt. 00394 00395 10. Gaseinlassorgan nach Anspruch 6, 7, 8 und 9 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, dass das 00396 00397 Auswechselteil (14) mit der Zuleitung (2, 4) verschraub-00398 bar oder im Wege eines Bajonettverschlusses verbindbar 00399 ist.

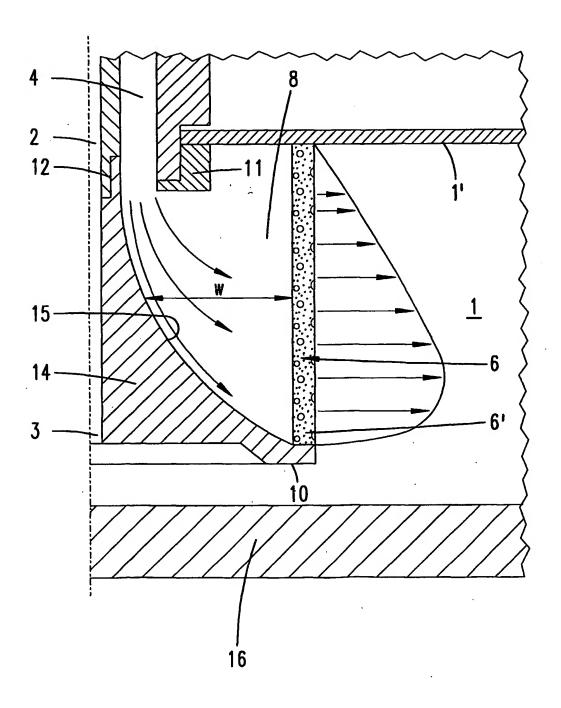


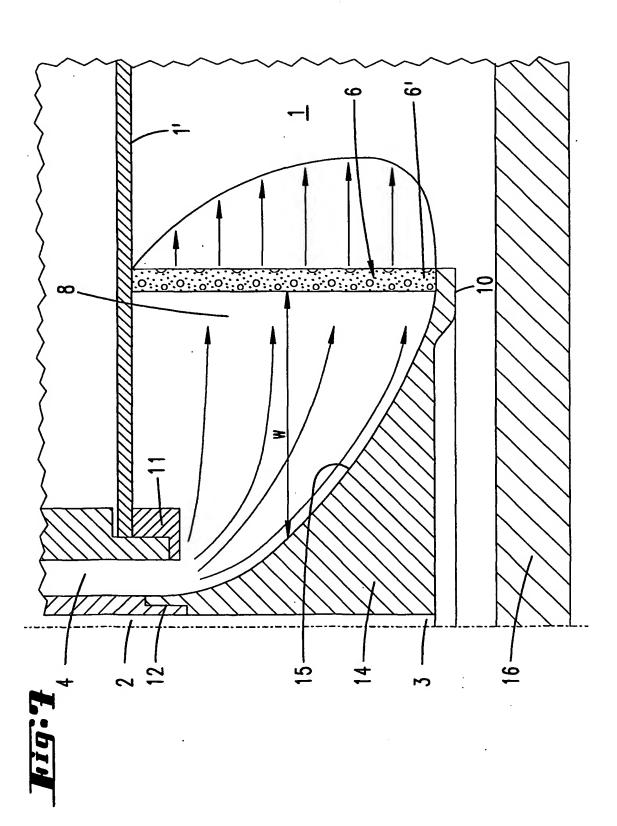




4/7

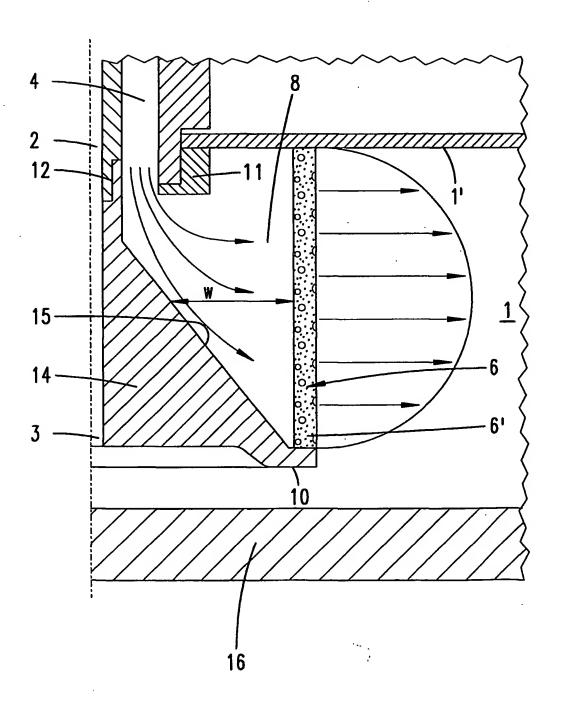
Fig.6





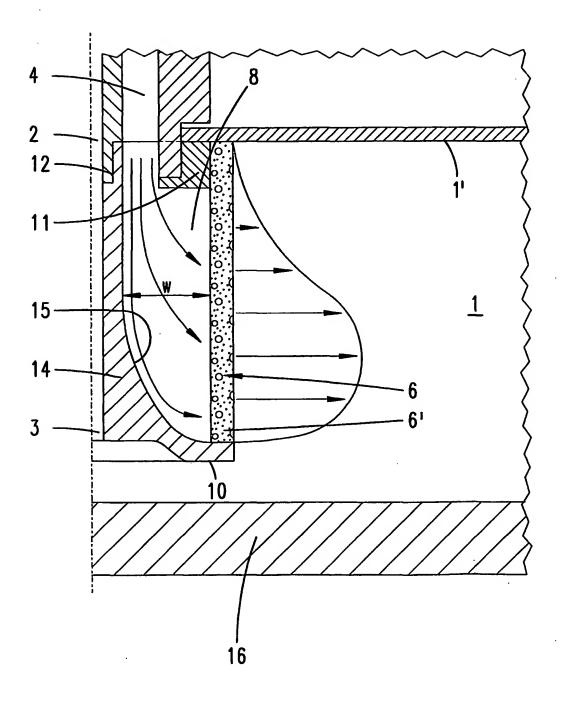
6/7

Fig. B



7/7

Fig. 9



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

tr onal Application No PCT/EP 01/08139

A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C30B25/14 C23C16/455		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	tion and IPC	
	SEARCHED .		
	cumentation searched (classification system followed by classification	n symbols)	
	C30B C23C		_
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the extent that st	ich documents are included. In the fields se	arched
Electronic da	ata base consulted during the International search (name of data bas	e and, where practical, search terms used)	
PAJ, EI	PO-Internal		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	want passages	Relevant to claim No.
Α	FRIJLINK P M: "A NEW VERSATILE, SIZE MOVPE REACTOR" JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, NORTH-		1,6
	PUBLISHING CO. AMSTERDAM, NL,		
	vol. 93, no. 1 - 4,		
	1 November 1988 (1988-11-01), pag	es	
	207-215, XP000034974 ISSN: 0022-0248		
	page 207 -page 209; figure 1		
		,	
	_	/	
	·	[
			•
			1
			0
 	I		
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.
Special ca	itegories of cited documents :	"T" later document published after the Inte	mational filing date
"A" docume	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the	
"E" earlier	document but published on or after the international	invention "X" document of particular relevance; the c	
filing of	ant which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do	
which		"Y" document of particular relevance; the c cannot be considered to involve an im	taimed invention
O, qocmu	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	document is combined with one or mo ments, such combination being obviou	re other such docu-
"P" docume	ent published prior to the international filing date but	in the art.	
	han the priority date claimed actual completion of the international search	*&* document member of the same patent Date of mailing of the international set	
1	1 December 2001	19/12/2001	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
1	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,	Cook, S	•
1	Fex: (+31-70) 340-3018	000K, 5	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Ir. Ional Application No PCT/EP 01/08139

0.00	ELLON) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Retevant to claim No.
A	FRIJLINK P M ET AL: "LAYER UNIFORMITY IN A MULTIWAFER MOVPE REACTOR FOR III-V COMPOUNDS" JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, NORTH-HOLLAND PUBLISHING CO. AMSTERDAM, NL, vol. 107, no. 1 / 4, 1991, pages 166-174, XP000246591 ISSN: 0022-0248 the whole document	1,6
A	EP 0 334 432 A (ELECTRONIQUE & PHYSIQUE; PHILIPS NV (NL)) 27 September 1989 (1989-09-27) the whole document	1,6
A	EP 0 334 433 A (ELECTRONIQUE & PHYSIQUE; PHILIPS NV (NL)) 27 September 1989 (1989-09-27) the whole document	1,6
А	BECCARD R ET AL: "A novel reactor concept for multiwafer growth of III-V semiconductors" JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, NORTH-HOLLAND PUBLISHING CO. AMSTERDAM, NL, vol. 198-199, March 1999 (1999-03), pages 1049-1055, XP004171007 ISSN: 0022-0248 figure 1	1,6
Α	US 5 954 881 A (THOMAS LINARD M ET AL) 21 September 1999 (1999-09-21)	
A	GB 1 056 430 A (TEXAS INSTRUMENTS INC) 25 January 1967 (1967-01-25)	
Α	WO 98 45501 A (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV ;PHILIPS NORDEN AB (SE)) 15 October 1998 (1998-10-15)	
		·

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

In tonal Application No PCT/EP 01/08139

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0334432	Α.	27-09-1989	FR	2628985 A1	29-09-1989
			DE	68909817 D1	18-11-1993
			DE	68909817 T2	28-04-1994
			EP	0334432 A1	27-09-1989
			JP	1278498 A	08-11-1989
			JP	2771585 B2	02-07-1998
			KR	137875 B1	01-06-1998
			US	5027746 A	02-07-1991
EP 0334433	Α	27-09-1989	FR	2628984 A1	29-09-1989
			DE	68908927 D1	14-10-1993
			DE	68908927 T2	24-03-1994
			EP	0334433 A1	27-09-1989
			JP	1278497 A	08-11-1989
			JP	2835338 B2	
			KR	137876 B1	
			US	4961399 A	09-10-1990
US 5954881	A	21-09-1999	NONE		
GB 1056430	Α	25-01-1967	MY	24569 A	31-12-1969
WO 9845501	Α	15-10-1998	WO	9845501 A1	15-10-1998
			EP	0917596 A1	26-05-1999
			JP	2000511705 T	05-09-2000
			US	6080642 A	27-06-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

t tionales Aktenzeichen PCT/EP 01/08139

a. Klassii IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C30B25/14 C23C16/455		
Mark	amathanaha Dataattikaakiinsii mina sharrah kara il	official and dec 9794	
	ernationalen Patentikassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas RCHIEFITE GEBIETE	Sinkation und der IPK	
Recherchier	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	le)	
IPK 7	C30B C23C		
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	tallen
Während de	r internationalen Recherche konsuttlerte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
PAJ, E	PO-Internal		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
	g		•
A	FRIJLINK P M: "A NEW VERSATILE, SIZE MOVPE REACTOR"		1,6
	JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, NORTH- PUBLISHING CO. AMSTERDAM, NL, Bd. 93, Nr. 1 - 4,	HOLLAND	
	1. November 1988 (1988-11-01), Se 207-215, XP000034974	iten	
	ISSN: 0022-0248 Seite 207 -Seite 209; Abbildung 1		
		/	
	·		
			·
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	Siehe Anhang Patentfamille	
'A' Verôffe	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntilichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, acht als besonders bedeutsam anzusehen ist	"T' Spätere Veröffentlichung, die nach der oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern na Erfindung zugrundellegenden Prhyzigs	nt worden ist und mit der er zum Verständnis des der
Anmel	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen idedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft er-	Theorie ängegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bede kann allein aufgrund dieser Veröffentli	utung die beanspruchte Erfindung ichung nicht als neu oder auf
anden	ier die aus einem anderen beschoeren Grund angegeben ist (wie	erfinderischer Tätigkeit beruhend betr "Y" Veröffentlichung von besonderer Bede kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung mi	utung die beanspruchte Erfindung kelt beruhend betrachtet
"O" Veröffe eine B "P" Veröffe	milichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, ienutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht milichung, die vor dem internationalen Armeidedatum, aber nach	Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fechman *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	n Verbindung gebracht wird und n nahellegend ist
	eanspruchten Prioritätsdatum verüffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Ro	
1	1. Dezember 2001	19/12/2001	
Name und I	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevoltmächtigter Bediensteter	
1	Europäisches Patientami, P.B. 5818 Patentiaan 2 Nii. – 2280 HV Rijswijk Tel. (431–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni.	01	
	Fax: (+31-70) 340-3016	Cook, S	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

tr tionales Aktenzeichen
PCT/EP 01/08139

C/Endoda	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	1 CI/EI UI	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	FRIJLINK P M ET AL: "LAYER UNIFORMITY IN A MULTIWAFER MOVPE REACTOR FOR III-V COMPOUNDS" JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, NORTH-HOLLAND PUBLISHING CO. AMSTERDAM, NL, Bd. 107, Nr. 1 / 4, 1991, Seiten 166-174, XP000246591 ISSN: 0022-0248 das ganze Dokument		1,6
A	EP 0 334 432 A (ELECTRONIQUE & PHYSIQUE ;PHILIPS NV (NL)) 27. September 1989 (1989-09-27) das ganze Dokument		1,6
Α	EP 0 334 433 A (ELECTRONIQUE & PHYSIQUE; PHILIPS NV (NL)) 27. September 1989 (1989-09-27) das ganze Dokument		1,6
A	BECCARD R ET AL: "A novel reactor concept for multiwafer growth of III-V semiconductors" JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, NORTH-HOLLAND PUBLISHING CO. AMSTERDAM, NL, Bd. 198-199, März 1999 (1999-03), Seiten 1049-1055, XP004171007 ISSN: 0022-0248 Abbildung 1		1,6
A	US 5 954 881 A (THOMAS LINARD M ET AL) 21. September 1999 (1999-09-21)		
A	GB 1 056 430 A (TEXAS INSTRUMENTS INC) 25. Januar 1967 (1967-01-25)		
A	WO 98 45501 A (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV ;PHILIPS NORDEN AB (SE)) 15. Oktober 1998 (1998-10-15)		·

l

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

in onales Aktenzeichen
PCT/EP 01/08139

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0334432	A	27-09-1989	FR	2628985 A1	29-09-1989
			DE	68909817 D1	18-11-1993
		•	DE	68909817 T2	28-04-1994
			EP	0334432 A1	27-09-1989
			JP	1278498 A	08-11-1989
			JP	2771585 B2	02-07-1998
			KR	137875 B1	01-06-1998
			US	5027746 A	02-07-1991
EP 0334433	Α	27-09-1989	FR	2628984 A1	29-09-1989
			DE	68908927 D1	14-10-1993
			ÐΕ	68908927 T2	24-03-1994
			EP	0334433 A1	27-09-1989
			JP	1278497 A	08-11-1989
			JP	2835338 B2	14-12-1998
			KR	137876 B1	17-08-1998
			US	4961399 A	09-10-1990
US 5954881	Α	21-09-1999	KEI	NE .	
GB 1056430	Α	25-01-1967	MY	24569 A	31-12-1969
WO 9845501	Α.	15-10-1998	WO	9845501 A1	15-10-1998
	•••		EP	0917596 A1	26-05-1999
			JP	2000511705 T	05-09-2000
			US	6080642 A	27-06-2000